

解析2026
最新技術與趨勢

DIGITIMES

COMPUTEX 2026



精選
議題

AI 光環外溢 CPU、
ASIC 躍上 COMPUTEX 主舞台

觀點
解析

| AI 電力瓶頸下的短期能源解方
| Agentic AI 引爆汽車產業新變革

慧榮 苟嘉章： AI 浪潮下的記憶體 榮景與斷鏈風險



苟嘉章指出，AI 推論所帶動的榮景，伴隨著嚴峻的供需失衡，預計將延續至 2027-2028 年。慧榮科技

生成式 AI 浪潮改變了產業的生態，起初市場目光大多鎖定在 NVIDIA 的 GPU 與先進封裝。廠商將稀缺產能幾乎全數押注在 HBM (高頻寬記憶體)，以支撐 AI 的訓練需求。然而，慧榮科技 (Silicon Motion) 總經理苟嘉章指出，隨著產業進入「推論 (Inference)」時代，這個認知正在被徹底翻轉。

自 2026 年 3 月 NVIDIA GTC 大會後，執行長黃仁勳明確讓市場看到 Vera Rubin 架構對 NAND 的巨大需求——隨著模型應用從訓練轉向推論，內容與上下文的存取變得至關重要。苟嘉章觀察到，市場已從兩年前「沒人關心儲存」演變成「沒有一家全球雲端服務大廠或智慧型手機大廠，其對 DRAM 與 NAND 的需求能被完全滿足」。甚至連儲存模組廠與記憶體大廠的股價，也因這波需求噴發及缺貨漲價，出現了數倍甚至十倍的驚人漲幅。

技術架構典範轉移： CMX 與邊緣 AI 的興起

苟嘉章分析，推論應用帶動了對大容量、高頻寬與高 IOPS 儲存的渴求。特別是 NVIDIA 定義的 CMX 情境記憶體儲存平台架構，要求每個 Rubin GPU 需配備 16TB 的硬碟，這意味著一套 NV72 Vera-Rubin 系統可能就需要超過 1 Petabyte 的儲存設備。NVIDIA 為因應 AI 推論快速成長的需求，推出了可由 GPU 直接存取的 CMX 儲存架構，讓 KV Cache 能夠充分發揮效益。此架構同時也為儲存產業帶來更多商機，但這也讓 NAND 的供貨更困難。

除了雲端伺服器，邊緣運算的應用也正在爆發。苟嘉章特別預估，隨著 Meta 等大廠推動，今年智慧眼鏡的出貨量將達到 6,000 萬支的驚人規模。這些穿戴式裝置對嵌入式儲存的需求，將成為 NAND 儲存市場另一股強大的成長動能，進一步加劇產能競爭。

慧榮作為全球控制器的領頭羊，正透過專利的 PerformaShape® 技術，解決多租戶環境下 GPU 存取空間時的 QoS 問題，確保在多個 GPU 同時進行推論運算或邊緣裝置存取時，傳輸速度不會下滑，奠定了慧榮在 AI 生態系中不可或缺的地位。

繁榮背後的陰影： 苟嘉章的斷鏈警示與「產能勸說」

然而，在景氣一片大好之際，苟嘉章直言目前的記憶體市場處於一種不平衡的現象。由於三星、海力士、美光等大廠為了追求最大利潤與滿足強勁 AI 雲端服務大廠的需求，將絕大部分的資本支出 (CAPEX) 轉向 HBM 與 DDR5，導致 NAND 的產能擴充受到嚴重擠壓。

「這對 NAND 來說是最好的時機，也是最挑戰的環境，」苟嘉章表示。為了防止 AI 擠壓效應導致傳統產業崩潰，他在過去八個月內積極奔走，會晤三星、海力士、Kioxia、SanDisk、YMTC 及美光等大廠，力勸他們保留一部分產能給汽車、手機及 PC 產業。他警告，如果這些基礎產業因為缺貨而斷鏈，邊緣 AI 將失去發展的土壤，最終將反噬整個科技生態系。

慧榮的策略布局： 從雲端到邊緣的穩定器

面對未來兩三年的缺貨潮，慧榮扮演的是「過渡方案的提供者」。當 NAND 原廠因資源集中於 AI 而外包非核心專案時，慧榮成為首選合作夥伴。在 PC 與手機市場因漲價而受挫時，慧榮協助客戶轉向車用、智慧物聯網 (AIoT) 等應用，例如今年出貨爆發的智慧眼鏡市場。

特別是在汽車領域，慧榮已耕耘十年。當大廠意欲放棄小眾需求時，慧榮主動承擔責任，確保全球汽車供應鏈不會因記憶體短缺而停擺。「我們不是只看營收長紅，我們希望盡到責任，」苟嘉章感性地表示。在 AI 帶來的榮景背後，慧榮正努力修補供應鏈的裂縫。

記憶體市場未來 2-3 年前景預估

當前儲存產業已正式進入推論與邊緣應用的爆發期。苟嘉章指出，這種榮景伴隨著嚴峻的供需失衡，預計將延續至 2027-2028 年。受限於土地取得困難、無塵室興建耗時以及半導體設備交期長達一年等結構性因素，新增產能短期內難以開出。苟嘉章預測，DRAM 的缺貨情況需至 2027 年底才可能緩解，而 NAND 的舒緩時間點會更晚。在產能、土地和無塵室極度有限的情況下，記憶體大廠優先投入 HBM 的策略，將使傳統 PC、手機、消費性電子及汽車應用面臨長期配置不足的挑戰。

在這樣的環境下，慧榮憑藉技術優勢扮演產業補位的角色。透過 PerformaShape® 技術，有效解決 AI 推論的效能瓶頸。在當紅的 AI 伺服器快速發展下，也藉技術優勢，提供企業級開機碟 (Boot Drive) 給 AI GPU、TPU 與 DPU 等全球領先企業。當原廠因資源吃緊而不得不將 PCIe Gen5 等主流與嵌入式專案外包時，慧榮便順勢承接商機，持續推升市佔率。特別是在智慧物聯網與車用等新興領域，慧榮提供穩定的控制器與儲存解決方案，填補了原廠產能位後或無人力支持的真空。

最後，苟嘉章強調慧榮作為控制器龍頭大廠，責無旁貸地擔負起了供應鏈保護與產能再平衡的領導者責任，協助全球客戶在複雜的地緣政治與產能競爭中尋求過渡方案，確保整體產業鏈在 AI 浪潮下不至於失衡亂套，進而能共同邁向穩健成長，迎接明亮的未來。

2026 COMPUTEX



精選議題

AI 光環外溢 CPU、ASIC躍上COMPUTEX主舞台 03

觀點解析

- AI電力瓶頸下的短期能源解方 AI資料中心將加速配置儲能系統 24
- Agentic AI引爆汽車產業新變革 智慧車邁入自主決策階段 30

品牌聚焦

- 慧榮苟嘉章:AI 浪潮下的記憶體榮景與斷鏈風險 01
- AI 算力邁向兆瓦 (GW) 時代 電力架構成為關鍵競爭力
英飛凌以「From Grid to Core」策略重構能源體系 08
- 和碩以 PEGAVERSE 平台擴大智慧製造布局
打造 AI 代理與數位孿生整合應用環境 12
- 智微科技領航 COMPUTEX 2026, 定義高效能儲存與數據管理新標準 15
- 廣和通亮相 COMPUTEX 2026 推動“連接 +AI”高價值場景落地 16
- 明緯COMPUTEX 2026展現升級布局 從電源供應跨足能源管理方案 20
- TSLG耐落 扣件防鬆價值解決方案提供者 39

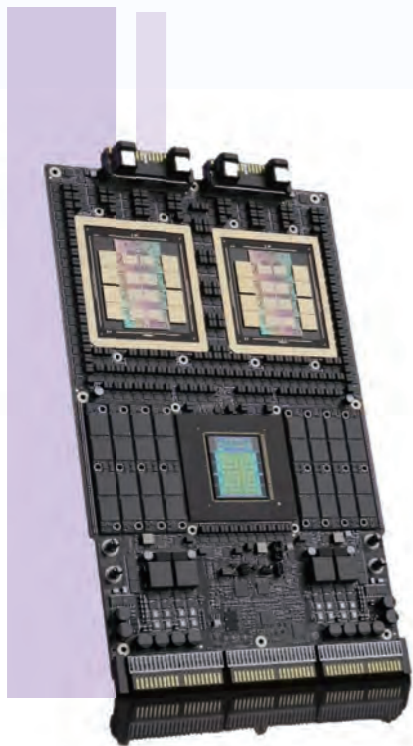
焦點廠商

41



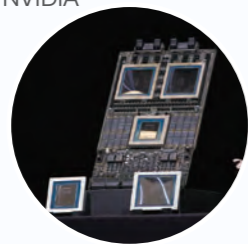
AI 光環外溢

CPU、ASIC躍上COMPUTEX主舞台



NVIDIA Vera Rubin NVL72 平台整合 Vera CPU、Rubin GPU 與 NVLink 6 高速互連技術，瞄準下一代 AI 資料中心的大規模訓練與推論需求。

NVIDIA



COMPUTEX 2026 登場，

展覽主軸定為「AI Together」，

聚焦在 AI 運算、機器人與智慧移動、次世代技術等。

值得注意的是，

有別於前 2 年焦點集中在 NVIDIA 與

AI 訓練所需要的運算架構，

2026 年除了 GPU 依舊是焦點外，

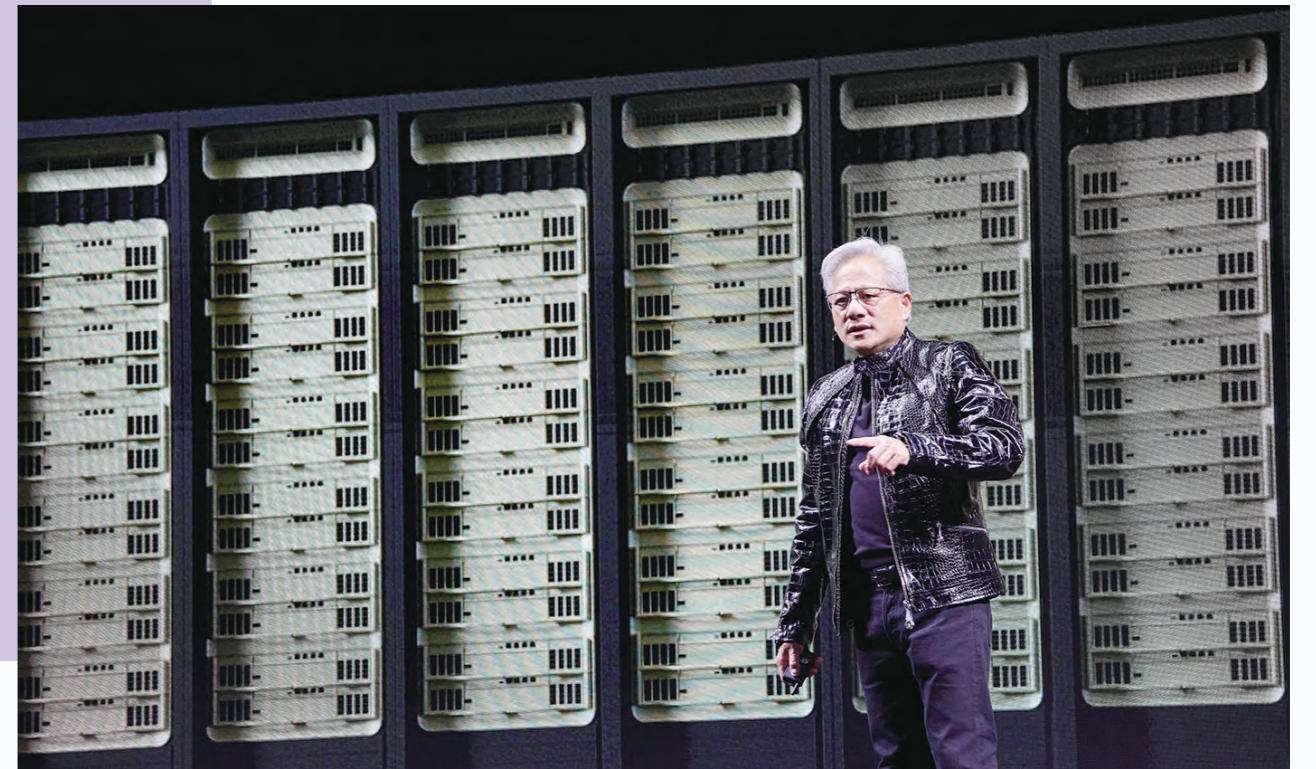
ASIC 與更多邊緣 AI 應用，也須關注。

COMPUTEX 2026 將吸引來自 33 國家 / 地區、超過 1,500 家廠商參展，展出規模達 6,000 個攤位。多位科技業重量級人士也將現身發表主題演講，包括英特爾 (Intel) 執行長陳立武、高通 (Qualcomm) 總裁暨執行長 Cristiano R. Amon、Marvell 執行長 Matt Murphy，以及恩智浦 (NXP) 總裁暨執行長 Rafael Sotomayor。

此外，NVIDIA 執行長黃仁勳將在展前一天 (6 月 1 日) 在台北流行音樂中心，發表主題演說，在展覽期間，也可望在展場現身，到各供應鏈的攤位上為合作夥伴站台致意，預料屆時會再掀起一波 AI 討論熱潮。

Vera Rubin 帶動 AI 伺服器升級 台廠展散熱、電力與系統解方

除了上述國際大廠外，國內重量級科技廠商都會在 COMPUTEX 展出旗下最新產品，包括聯發科、鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、仁寶、和碩、華碩、宏碁、技嘉、微星、台達電、光寶科、勤誠、雙鴻、高力等。



NVIDIA 執行長黃仁勳預計在 COMPUTEX 2026 展前一天發表主題演說。

李建樑攝 (資料照)

鴻海將於 COMPUTEX 展示最新 AI 伺服器垂直整合能力，涵蓋先進架構、關鍵零組件到系統整合；同時也將展示 CPO、機器人等前瞻技術與應用成果。現場亦將完整呈現 AI 如何導入 Smart Manufacturing、Smart EV 與 Smart City 等平台，展現集團實力與佈局。

廣達及旗下雲達科技 (QCT) 展出重點將聚焦 NVIDIA Rubin 架構、100% 液冷技術以及代理型 AI (Agentic AI)。此外，廣達及雲達也會展出包括英特爾、超微 (AMD) 等相關的 AI 解決方案。

緯創、緯穎、英業達、仁寶等 ODM 大廠，也將鎖定 AI，展出旗下 AI 與通用 (general purpose) 伺服器的相關解決方案，此外，由於 AI 晶片功耗與 ESG 需求，液冷散熱也將會是各家展出的重點。

NVIDIA 預計下半年將推出的新一代 AI 架構：Vera Rubin，必定是 COMPUTEX 2026 的焦點，隨著 Vera Rubin 架構演進，AI 伺服器也將推升至新階段，包括 100% 液冷散熱、及 800V 高壓直流配電、機架電源櫃 (Power Rack) 等，相關設計也會是展場焦點。

NVIDIA 作為 AI 世代推進的領頭羊，一舉一動勢必會是 COMPUTEX 的焦點，NVIDIA 之前在 CES 與 GTC 大會展出的 Kyber Rack，也可望在 COMPUTEX 亮相，從前幾代 Compute Tray 的設計，轉變為 Compute Blade，其展示區預料將是人潮聚集處。

AI 推論帶旺 CPU 需求 通用伺服器動能升溫

值得注意的是，AI 商機與光環，正從 NVIDIA 持續外溢到他廠，主因是 AI 影響力持續擴大，從過去集中在大語言模型的 AI 訓練，開始朝 AI 推論 (Inference) 領域邁進，其結果是英特爾、AMD 等 CPU 廠，也開始受惠。

近期通用型伺服器動能明顯轉強，英特爾與 AMD 的處理器供不應求，是重要觀察指標。英特爾指出，過去以 GPU 為主的 AI 訓練階段，GPU 與 CPU 用量比例約為 8:1，隨推論與代理 AI 興起，比例已降至 4:1，未來甚至可能趨近 1:1 甚至反轉。



英特爾執行長陳立武預計6月2日進行COMPUTEX主題演講。
李建樑攝（資料照）



Google 第 8 代 TPU，首度採用雙晶片架構。Google Cloud

英特爾日前繳出優異的財報成績單，且對外釋出需求強勁，供不應求的樂觀訊息。英特爾執行長陳立武預計 6 月 2 日進行主題演講，屆時將會揭示更多從英特爾觀點來看到的 AI 機會。

DIGITIMES Research 指出，2026 年第 1 季全球伺服器出貨優於預期，較上季成長 4%，Agentic AI 工具的流行不但加速了 GPU 與 ASIC 在 Token 產出的耗用，其自動化過程中的任務協調、工具調用則需大量依賴 CPU，使雲端業者將出貨重心轉向通用型伺服器。

該報告也指出，品牌商來自二線雲端業者的 AI 與通用型伺服器訂單增長強勁，傳統企業客戶亦因伺服器漲價及 Agentic AI 布局需求而啟動換機，以上皆造成第 1 季出貨優於預期。全球伺服器第 2 季出貨量預估將首次突破 500 萬台大關，季增 8.6%，年增逾 3 成。

此外，從訓練到推論，AI 也更廣泛應用至各層面，帶動實體 AI 的發展，包括機器人、自駕車、

智慧工廠到智慧城市，AI 幾乎無所不在，不只資料中心基礎建設相關的供應鏈，包括應用端的廠商，諸如達明、所羅門、研華、新漢等廠商，也都是受矚目的重點。

Google TPU 領軍 ASIC 伺服器起飛 台廠搶搭新成長浪潮

ASIC 伺服器也是另一 COMPUTEX 需關注焦點，CSP（雲服務商）自行開發的 ASIC 日益成熟，由 Google TPU 伺服器領軍的 ASIC，無疑是 2026 年 AI 伺服器成長最快的族群，除了鴻海、廣達、緯穎、英業達等系統廠外，IC 設計的聯發科，更是萬眾矚目的廠商。

聯發科近期頻頻「上修」，不僅上修 2026 年 ASIC 營收的目標，從原先預估的 10 億美元倍增到 20 億美元，連整個 ASIC 領域的總潛在市場（TAM），也從原先預估 2028 年才會到達 700 億~800 億美元的時程，直接提前到 2027 年達標。

聯發科執行長蔡力行指出，過去 1 季以來整個 ASIC 市場的熱度進一步攀升，客戶對於相關晶片的需求只比先前更加急迫。近期聯發科也證實，邀請台積電研發六騎士之一的退休大將余振華，擔任非正式顧問一職，市場看好聯發科在先進封裝的整合能力再提升。

賦能AI與資料中心的 連接器解決方案

歡迎蒞臨攤位

觀看TE Connectivity與Wiwynn 共同展示的示範產品

■ 展覽日期 | 2026年6月2日（二）至6月5日（五）
■ 展出地點 | 南港一館 AI運算與科技區 J0106

英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White 將於 6 月 4 日在 COMPUTEX 論壇發表主題演講〈Infineon：驅動 AI 時代的能源關鍵，從電網到核心再到實體 AI〉，歡迎您一同洞悉 AI 時代能源版圖的新趨勢。

AI 算力邁向兆瓦 (GW) 時代 電源架構成為關鍵競爭力 英飛凌以「From Grid to Core」策略重構能源體系



英飛凌針對未來 AI 資料中心所提出的從電網到處理器核心電力架構演進藍圖。

進入 2026 年，電源管理已從過去的基礎支援角色，躍升為 AI 產業最關鍵的戰略核心。在這場典範轉移中，英飛凌以「From Grid to Core (從電網到處理器核心)」的完整願景，重新定義 AI 時代的能源基礎架構。

AI 規模化的關鍵

AI 的演進速度，早已超越傳統摩爾定律的節奏。隨著模型參數規模與即時推理需求的爆發式成長，算力需求正呈現指數型擴張。

目前，單顆 GPU 的功耗正快速逼近 kW 級水準，而資料中心機櫃的功率密度，也已從過去的不到 60kW，大幅提升至超越 100kW，並正邁向 MW 等級的全新門檻。

這不僅是數字上的成長，更代表電源架構的結構性躍遷。當算力叢集飛速成長，傳統 48V 匯流排與 AC 配電架構所面臨的能量損耗、熱管理與空間限制，正迅速逼近其物理極限。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White 強調，未來 AI 基礎設施的競爭，將不再只是晶片效能的比拼，而是一場涵蓋電力電子、材料科學與系統架構的跨領域整合戰。

從電網到核心：重構 AI 的電力架構

在這樣的產業轉折點上，英飛凌的關鍵優勢，不在於單一產品技術，而在於其橫跨整個電力路徑的系統級掌控能力。

「From Grid to Core」並非單純的產品布局，而是一套重新定義 AI 能源體系的三層架構，同時也是英飛凌與全球雲端服務業者及系統夥伴自架構初期即共同設計的成果。

電網層：以高壓直流 (HVDC) 實現 永續且高效率的供電

在資料中心的入口端，電力系統正經歷從傳統機械式設備走向固態化的重大轉型。未來 AI 資料中心將逐步演進為高度自主的直流微電網。透過採用碳化矽技術的固態變壓器 (SST)，設備重量可從 20 噸縮減至 500 公斤，同時實現超過 1% 的效率提升。

這不僅意味著空間與成本的優化，更標誌著電力設備正從機電系統轉變為高度半導體化的架構，進一步催生出全新的半導體應用市場。隨著 SST 與相關技術的導入，AI 電力基礎設施正逐步形成一個具備數十億美元潛力的新興市場版圖。

搭配具備微秒級反應能力的固態斷路器 (SSCB)，以及可進行即時監測與遠端控制的數位化電力系統，電網已不再只是電力來源，而成為可被觀測、分析與優化的智慧節點。

機櫃層：重塑功率密度並極大化能源效率

當資料中心進入兆瓦 (GW) 級時代，電力分配架構也必須全面革新。

英飛凌正推動產業從傳統 48V 系統，邁向 ±400V 與 800V 高壓直流架構，並透過三相電源 Sidecar 設計，將電力供應與運算系統重構，建立更高效率與更高彈性的電力分配模式。

同時，AI 資料中心電力架構也正依循明確的演進路徑推進：從整合式機櫃邁向高壓直流與側櫃供電的設計，並最終進入結合直流微電網的兆瓦級基礎設施。

氮化鎵元件的高頻特性，使得中間匯流排轉換器 (IBC) 得以在極小體積內實現超過 98% 的轉換效率與極高功率密度，大幅降低電力傳輸損耗，並釋放更多空間給 AI 運算資源。



英飛凌電源與感測系統事業部總裁 Adam White (右)、英飛凌零碳工業功率事業部總裁 Peter Wawer (左)

核心層：面向新一代 AI 運算的功率密度與新架構

在電力傳輸的最終端—處理器核心，挑戰轉向極致電流密度與瞬態響應能力。

面對下一代 GPU 對超高電流與快速負載變化的需求，英飛凌推出數位多相 PWM 控制器與業界首款 TLVR 四相模組。利用高精度遙測與數位控制技術，電源系統已從被動供應，轉變為可即時監測、預測與優化的智慧平台。電力不再只是支撐 AI，而是成為可被管理與調度的運算資源之一。

從雲端走向實體世界

如果說資料中心是 AI 的算力核心，那麼實體世界，將是 AI 價值真正被釋放的場域。隨著 AI 逐步走向人形機器人、自主系統與智慧製造設備，對於能源效率、即時反應與系統穩定性的要求，將更加嚴苛。

英飛凌正將其資料中心累積的電力管理能力，延伸至 Physical AI 領域，結合感測、致動、安全、連接方案與高效能電源模組，打造能夠讓機器人感知、思考、連接與執行的完整系統能力，同時維護功能性安全與資訊安全，讓 AI 不只能運算，更讓 AI 能行動。

推進 AI 的能源極限

「We Power AI」不僅是英飛凌的一句口號，而是一項對產業未來的具體承諾。從兆瓦級資料中心，到現實世界中的智慧機器人系統，英飛凌正持續推動電力技術的極限，讓每一瓦能源都能轉化為最大化的 AI 價值。

當產業邁向下一個算力世代，真正決定勝負的，不再只是誰能設計更強的晶片，而是誰能掌握能源。

而在這場競爭中，英飛凌正攜手生態圈合作夥伴，站在定義未來的位置上。

ENABLING THE FUTURE OF MULTIMODAL HMI

Designed for seamless integration into your system

Core Technologies

Edge-AI | Touch | Pressure | Gesture | Haptics

Rugged Performance

Waterproof | Thick Glove | Noise Immunity

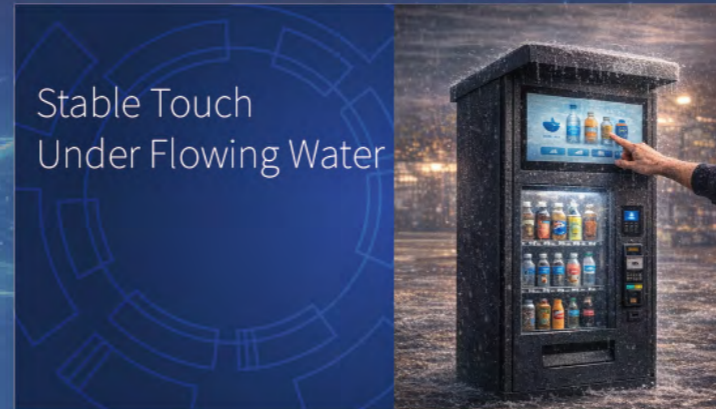


Built for Harsh Environments

Flowing water
Wet surfaces
Seawater environments
Gloved operation
Industrial and outdoor environments

APPLICATIONS

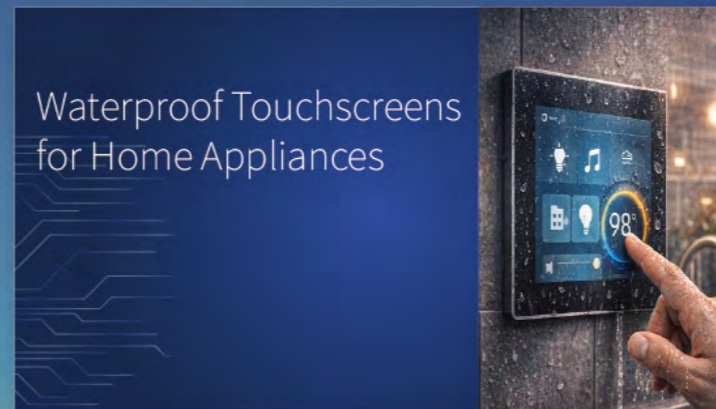
REAL-WORLD HMI DEPLOYMENTS



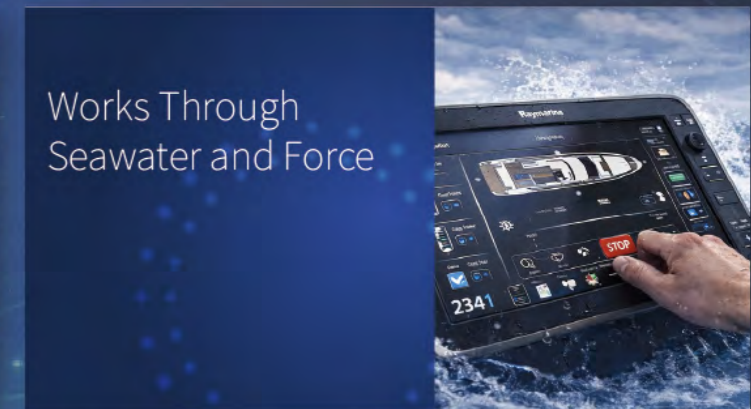
OUTDOOR KIOSKS & TERMINALS



INDUSTRIAL CONTROL PANELS



SMART HOME APPLIANCES



MARINE ELECTRONICS



Imagination Broadway Ltd.

www.imagebroad.com

PEGATRON



和碩以 PEGVERSE 平台擴大智慧製造布局 打造 AI 代理與數位孿生整合應用環境

人工智慧代理 (AI Agent) 的開發與 AI 推論 (Inference) 能力的快速發展，在智慧製造領域中開始在底層架構上型塑大幅度的變革，將過去在製造現場端使用基於規則的系統 (Rule-based System)，進而轉成機器自我進化跟學習，如 AI 領域 Continuous learning, lifelong learning, active learning, test time adoption，一舉讓企業界從知識存儲、處理訊息並做出決策的邏輯展現不一樣的樣貌。

和碩聯合科技 (PEGATRON，簡稱「和碩」) 早在 2012 年就啟動部署 AI 賦能智慧製造專案，多年所累積寶貴經驗下，若只追求單點或建立自動化流程的改善並不足以解決企業內真正的痛點，而真正彌足珍貴之處，反而是在於跨組織、跨流程的優化過程中，發掘高附加價值產品與流程的開發，並助力提高企業的競爭力的目標追尋，這往往比 AI 技術的駕馭更顯得重要。

和碩聯合科技副總經理暨人工智慧長蕭安助先生在 Computex 2026 展覽前夕接受這次的專訪，他觀察到當 AI Agent 的能力大幅度超前時，打造一個 AI

Agent 原生應用的環境變的更加重要，讓這些通用的 AI Agent 可以迅速迭代、累積能力，和碩一舉開發「PEGVERSE」企業級平台，把發展 AI 所需要的底層算力、模型建立，以及 Data Pipeline (資料管線) 做好，可以讓不同性質的 AI 應用得以在同一架構下穩定並行運作，也為後續更多的 AI 創新保留了高度彈性空間，也是因為 PEGVERSE 平台，和碩轉而致力於建立一套能被組織吸收、延續並快速複製到跨事業體與跨區域的整合策略。

蕭安助對於 AI Agent 的定義是感知環境、採取行動的 AI 應用，而數據與 AI 工具將貫穿整個應用的需

求，企業設定目標讓 AI 工具來完成，擷取真實環境中的數據，並透過數位孿生 (Digital Twin) 的虛擬環境的模擬相搭配，找出解決問題的辦法，建立可持續改善的流程，而 AI Agent 需要一個可以試做的環境，並從犯錯過程中快速修正步驟，以提高作業效率，透過 AI Agent 與數位孿生技術間的互補，讓和碩可以持續打造高附加價值的使用範例。

AI 助力處理製造現場物理環境不確定性的機台自適性的挑戰

蕭安助特別舉出兩個使用範例，用在滿足製造端生產機台的自我調校的需求，第一個例子是解決點膠機的動態點膠路徑的挑戰，以前多半靠工程師自己反覆試錯與修正找到最佳的點膠路徑，現在利用 AI 來進行模擬點膠用的機器手臂的行走順序與路徑的規劃，解決高精準度和高可靠性要求所面臨的技術與時效上的挑戰，透過數位孿生模擬複雜的實際環境，涵蓋考量膠量大小的控制，還有斷膠、溢膠等狀況的掌握，並將模擬結果成功應用於實體機器手臂的點膠作業中，並做到動態調整的 AI 實作，大幅提高機台的良率。

另一個範例是因應台灣電子供應鏈面臨走向大規模海外擴廠的布局挑戰，對於大規模的機台部署與安裝時，由於各個廠區樓地板的高低不一、公差相異，以前需要先固定廠區的物理環境參數後，才在軟體上做優化以解決精密高低差的問題，現在利用感測器的偵測與資料回饋做到機台自我調校的能力，善用 AI 來處理現場環境的不確定變動時的機台自適性的調整，這在處理海外廠大規模的機台部署時，利用 AI 軟體主動適應物理環境不斷變動的環境，以完成機台對位與調校安裝的問題，這對製造端現場的幫助非常明顯。

AI Agent 讓中小企業進入新的公平競爭的起點

這些實際的案例都發現到多個 AI Agent 搭配數位孿生環境的實質效益，打造軟體的自我調整與解決問題的能力成為驅動 AI 革命的新篇章，對於 AI Agent 風潮所帶來新的機會，蕭安助認為中小企業完全可以與大企業擁有平起平坐的地位，尤其中小企業具備靈活性，也較沒有組織規模的包袱，更容易藉此找到更好的位置，AI Agent 是一個新的公平競爭的機會，大企業與小企業的立足點一樣，唯一的差異在於掌握快



和碩聯合科技副總經理暨人工智慧長
蕭安助

速轉型與擁抱改變的速度，依據目前 AI 發展的路線圖來看，過去企業經營看管理幅度，現在則是看管理 AI Agent 的幅度。

和碩的 PEGVERSE 平台打造 AI Agent 原生應用 (AI-Native Application) 與 AI ready 的環境，容納多個 AI Agent 一起運作與共同處理的空間，幫助提升自主化營運的能力，透過底層在算力的支持，大量使用沙盒 (Sandbox) 技術在虛擬空間中模擬並訓練不同的 AI Agent，並為駕馭未來數量龐大的 AI Agent 為原生的創意平台預做準備，協助企業針對不同的痛點與瓶頸逐一解決，並創造企業在 AI Agent 使用上最大的價值。

VL610/VL610D

DP2.1 HBR3 MST Hub

VL610 : 3 Video Streams	VL610D : 2 Video Streams
DP 2.1 HBR3 RX	1 Fixed HDMI2.1 2 Settable DP++/HDMI
Logo Display	Best for VL832 USB4® & TBT5
Lowest Power in Field	DP2.1 Protocol & VRR

QHD QHD QHD QHD144x3
4K 4K 4K 4K120/144x2 4K240

VL605/VL605D

USB-C® to HDMI2.1 PCON

DP to HDMI 2.1	2-Port USB PD3.1 EPR
Best VRR in Field Intel/AMD/Apple/NVDA/QMM	
MacOS 26 4K240/VRR/HDR	Reduced BOM & Lowest Power
VL605 (DP 4-Ln) Best for VL832 USB4® & TBT5	VL605D (DP 2-Ln) Best for DP Alt-mode

2-Port PD 4K240 VRR



智微科技領航 Computex 2026

定義高效能儲存與數據管理新標準

Industrial-Grade Hub

VL819i / VL822i	VL122i / VL123i	VL818 / VL823
USB 5Gbps/10Gbps Hub Controller	USB 2.0 Hub Controller	USB 5Gbps/10Gbps Hub Controller
USB-C®	STT / MTT	USB-C®
Industrial-Grade	Industrial-Grade	DFP w/ Mux + CC Logic
Low Power Design	Low Power Design	Integrated BB + HID
Configurable	Configurable	Configurable
Integrated BB + HID	Integrated Regulators	Support PortSense™
Support PortSense™	2/4 Ports	Low Power Design

全球高速橋接晶片 (Bridge IC) 領導廠商智微科技 (JMicon Technology Corp.) 宣布，將於 Computex 2026 隆重發表年度核心新品。憑藉多年深耕高速傳輸介面技術並廣獲市場肯定的實績，JMicon 本次以「極速效能、智慧備份、超大規模擴充」為主軸，展示多項突破性的儲存解決方案，展現其持續引領數位儲存生態創新的關鍵實力。

面對大數據與專業儲存市場對高效能與資料安全的嚴苛需求，JMicon 推出三款關鍵晶片：JMS591、JMS591U 與 JMB595。

JMS591 專為多盤位硬碟陣列應用打造，支援 USB 20G 與 eSATA 介面，在 RAID 0 模式下讀寫效能突破 2000 MB/s，為 NAS 與 DAS 系統提供卓越效能基礎。

JMS591U 鎖定企業級與專業應用市場，整合獨家 Offline Clone & Erase 技術，支援 1 對 4 高速克隆 (磁碟拷貝)，以及符合 DoD 標準

的資料清除機制，為資料遷移與資安合規提供一鍵式解決方案。

JMB595 則為 PCIe Gen4 x4 轉 16 埠 SATA III 的高階擴充晶片，透過級聯架構最高可連接 240 顆儲存裝置，完美滿足超大規模資料中心與監控儲存系統的擴充需求。

智微科技行銷暨業務副總經理林明正表示：「JMicon 長期致力於將複雜的高速傳輸技術轉化為直覺且強大的硬體解決方案。本次於 Computex 展出的新品，不僅將儲存讀寫效能推升至 2000 MB/s

的新里程碑，更透過整合式 RAID 引擎與離線複製技術，精準回應客戶在超大容量儲存與資安合規方面的關鍵需求。我們不只是晶片供應商，更是客戶在數據時代中建構穩健基礎的策略夥伴。」

智微科技誠摯邀請全球合作夥伴與媒體蒞臨 Computex 2026 JMicon 展位。期待透過面對面的交流與最前瞻的技術展示，與您共同探索儲存技術的未來趨勢，攜手開創高效傳輸與智慧數據管理的新紀元。

COMPUTEX 2026
展位資訊

VIA Labs, Inc. in USB-IF Community (Booth N0614)
Taipei Nangang Exhibition Center

VIA Labs, Inc. 威鋒電子股份有限公司
www.via-labs.com



VLI Facebook



VLI Website

與我們相約 COMPUTEX 2026

蒞臨 K0122 展位，探索未來科技新可能

廣和通亮相 COMPUTEX 2026

推動“連接+AI”高價值場景落地

2026年6月2日—5日
台北南港展覽館1館

在 COMPUTEX 2026 上，廣和通圍繞端側 AI 的落地路徑提出判斷：AI 從雲走向終端的過程中，決定其規模化能力的關鍵，不僅在於模型能力，更在於連接穩定性與本地計算能力的協同。

基於這一認知，廣和通持續強化“連接+AI”的一體化能力體系。一方面，以通信模組為核心，構建覆蓋 FWA、AI CPE 及新一代 Wi-Fi 8 的連接產品矩陣，提供高速率、低時延、高可靠的通信基石；另一方面，通過引入全棧 AI 解決方案，強化端側 AI 能力，使終端具備本地感知與處理能力，提升 AI 應用在複雜環境下的穩定性與回應效率。

面向端側智慧場景，廣和通發佈了龍蝦智算盒 (Fibocom ClawBox)，這是一款原生適配 OpenClaw、Hermes Agent 等智慧體的高能效 AI 計算終端。產品基於高性能異構算力架構，集成 CPU、GPU 與 NPU，提供最高 18TOPS@INT8 混合精度算力，在典型 5W 級功耗下實現高密度、多工並行推理能力。支援多路視頻解析、複雜視覺結構化、語音與多模態模型推理，具備低時延、

高可靠與當地語系化部署能力。配合廣和通的 Skill Hub，廣泛應用於安防、交通、機器人等端側智慧場景，支撐各類行業智慧化應用的規模化落地。

本次 COMPUTEX 2026，廣和通將在 K1022 展位，集中展出 AI 陪伴、智慧割草機、移動機器人解決方案等多項成果，呈現“連接+AI”在高價值場景中的應用成果，歡迎業界夥伴蒞臨交流。

Quality Innovation Powering AI

ZEISS

Driving AI Hardware Efficiency Through
Application-Led Quality Solutions



■ 展覽日期 | 2026年6月2日(週二)至6月5日(週五)

■ 展出地點 | 台北南港展覽館一館 | 攤位編號 J1109

預約參觀制

Amphenol

安費諾 - 全方位資料中心互聯技術 主宰AI叢集算力

從銅纜、光通訊到電源傳輸、光收發器與先進封裝架構，我們以全球化規模與深厚工程實力為後盾，提供業界最完整的資料中心高速互連解決方案。

隨著 AI 算力需求由單一節點演進至機架與超大規模叢集 (Hyperscale Clusters)，安費諾持續突破實體層的傳輸極限。我們深度整合次世代光通訊與先進基礎架構互連技術，打造涵蓋「運算擴展、電源與散熱、高密度儲存與基礎設施資安」的頂尖AI生態系，憑藉不容撼動的技術優勢，重塑 AI 算力的終極邊界。

安費諾為現代化 AI 資料中心，提供業界領先的端對端銅纜、光通訊與電源互連解決方案。

關於安費諾

安費諾公司是全球規模領先的電子、電機和光纖連接器、互連系統、天線、感測器產品，以及同軸電纜、高速纜線、光纖與特種線材的設計、製造與供應商。安費諾在全球約 40 個國家設有設計、製造和組裝基地，並透過全球業務團隊、獨立代理商及全球電子零組件通路商網路銷售產品。安費諾在互連市場多個高成長領域擁擁有多元化佈局，包含汽車、商用航空、通訊網路、國防、工業、資訊科技與資料通訊以及行動裝置。

了解更多資訊，請造訪：www.amphenol.com

探索安費諾現代化 AI 資料中心解決方案

Amphenol 安費諾
南港展覽館一館, 1 樓



查看更多
互連解決方案



追蹤
LinkedIn
掌握最新資訊

J0632 展位

AI INFRASTRUCTURE BLUEPRINT

Scale-Up AI



ExaMAX® Cable



ZettaMAX™



Celerity™

Scale-Out AI



EXTREMEPORT™
OSFP-XD 112G



OSFP-XD



XPO-LPO Optical
Transceiver

Rack-Scale Power & Thermal



Liquid Cooling Leakage
Detection Sensor Cable



60A DC Whip

Data Center Storage



DDME



Mini Cool Edge IO

Security & Infrastructure AI



Liquid Cooling
Busbar



MCIO Gen7



LUSB

明緯展出兩大電源新品系列，下為 NSP 全系列新世代內建 PFC 高可靠小型高效機殼電源，上為 XDR 全系列新世代超薄導軌電源，展現高效能、小型化與智慧應用整合實力。



明緯 Computex 2026 展現升級布局

從電源供應跨足能源管理方案



在 AI 運算帶動用電需求攀升、企業節能減碳壓力升高，以及全球市場日益重視電網韌性等趨勢下，電源供應器產業角色正由傳統供電元件，逐步延伸至能源效率與系統管理核心。針對此趨勢，全球標準電源供應器領導品牌明緯集團 (MEAN WELL) 將於 COMPUTEX 2026 展出一系列智慧照明與能源管理平台等方案，協助企業提升能源使用效率、強化營運韌性，並回應智慧化與永續發展需求。

明緯今年於 COMPUTEX 聚焦系統整合，將電源延伸至控制、通訊與能源管理平台，建構一站式架構。其中，雙向電源 BIC-5K 系列為本次展覽亮點，功率較前代提升，對應家用與中小型商用儲能需求，並支援併網法規與 V2G 應用，強化電動車、儲能與電網間的能源調度彈性。

除新能源產品外，明緯同時聚焦 XDR 導軌電源與 NSP 機殼電源。兩大系列強調高效率、寬溫、小型化與峰值功率，在有限空間內提供穩定供電，並支援高低溫與瞬間負載需求。其設計可降低轉換損耗與散熱需求、減少用電成本，小型化提升系統配置彈性，寬溫特性適用於嚴苛環境，峰值功率則避免過度配置電源容量。在實務應用上，有助降低建置與營運成本、提升能源效率與系統穩定性，同時支援企業減碳與 ESG 目標。

明緯也透過展示套件 (Demo Kit) 呈現方案導向策略，如以 DALI-2 為基礎的智慧照明系統，整合電源、控制器與感測器，支援調光、場景設定與人因自動化，兼顧節能與使用體驗。同時，攜手 ESG 夥伴推出 EOS 能源管理系統解決方案，串接電源設備、電表與儲能系統等，協助企業掌握用電數據、制定最佳化用電策略。從盤查到建置，明緯提供完整方案，協助企業建立可持續運作的智慧能源架構。

明緯未來將持續以電源技術為核心，提供整合型高效能電力解決方案。本次展出的 BIC-5K、XDR、NSP 系列及相關方案，將於 COMPUTEX 2026 亮相，展現朝高附加價值與智慧能源服務發展的最新布局。

BIC-5K AC/DC 饋網型雙向 能源轉換電源供應器

高效雙向轉換 · 智慧能源核心方案



AC → DC 和 DC → AC 雙向電源轉換器，快速雙向切換響應時間 1ms (AC → DC)



多領域全球認證
(ITE62368-1、電力電子轉換器62477-1、交流電網系統50549-1)



支援 CAN Bus 或 MODBUS-RTU
(RS-485) 協定通訊



保護功能：
主動式孤島保護、AC 異常保護、DC 過電壓保護、過負載保護、短路保護、過溫度保護



並聯同步運轉高達 30KW (5+1台)



產品說明頁

展覽日期：2026年6月2日(二) ~ 6月5日(五)

展覽地點：台北南港展覽館 1 館 1 樓 | 攤位編號：

K0725a



AI Fearlessly

AI threats move fast.
We move first.

Welcome to visit
TrendAI Booth

📍 L0417a

01



Lead the future of AI, AI fearlessly

02



Enabling Peace of Mind Across Your
Family in the AI Era



04



Powering the Sovereign
Integrated AI Value Chain

03



Secure Physical AI for
Real-World Safety



Reserve First! >>



Agentic AI 引爆汽車產業新變革 智慧車邁入自主決策階段

近期 Agentic AI 快速發展，已成為推動汽車產業智慧化升級的關鍵力量。相較於生成式 AI 或單一 AI Agent，Agentic AI 以多個 AI Agent 協同運作為核心，並結合外部工具調用能力，透過共享記憶與持續迭代學習，建立跨模組整合與自主決策架構。Agentic AI 不僅能完成複雜目標，更能因應動態環境調整策略，為自動駕駛、智慧座艙以及智慧製造的發展帶來極大突破。

AI 能力大洗牌

Agentic AI 躍升最高階智慧形態

在汽車產業中，不同 AI 類型在核心能力與應用範疇上呈現明顯分層。生成式 AI 主要聚焦於內容創建，例如在智慧座艙中生成語音、圖像或對話內容，已具備高商用成熟度。然而，其運作本質仍屬於輸入到輸出的單向模式，缺乏任務規劃與自主決策能力。

AI Agent 則透過大型語言模型結合外部工具與有限記憶，可在特定場景中執行任務，例如協助導航規劃、餐廳訂位或提供駕駛建議。AI Agent 已具備初步的任

務處理能力，但其邏輯仍侷限於單一 Agent 架構，難以應對跨系統、跨模組的問題。

相較之下，Agentic AI 可透過多個 Agent 之間的協作與記憶共享，形成具備集體智慧的系統架構，可針對複雜目標進行任務拆解、角色分工與策略調整，並依據情境進行自主判斷與行動。在車用場景中，可實現達成跨模組的任務，例如結合自駕決策、座艙互動與雲端服務。

從單一模型到多 Agent 協作

AI 決策系統全面升級

Agentic AI 的核心運作機制，在於多個 AI Agent 之間的協作，並將大型語言模型作為推理中樞，形成一套可自主學習與持續優化的系統架構。透過這樣的設計，系統不僅能執行任務，亦能在行動過程中觀察環境、累積經驗，進一步優化，使整體能力隨時間持續成長。

在此架構中，大型語言模型扮演大腦的角色，負責自然語言理解、邏輯推理與任務規劃。當系統接收到目標後，大型語言模型可解析複雜指令，並拆解為多步

驟行動，協調不同 Agent 執行任務，提升整體決策效率與彈性。

綜上所述，Agentic AI 並非單一大型模型，而是由多個功能專一的 AI Agent 所組成。此外，Agentic AI 具備記憶與工具使用能力。系統可將過往決策與經驗儲存，作為後續任務參考，降低錯誤重複發生的機率，同時亦可透過 API 或外部工具擴展能力範圍。

自駕、座艙、製造三線齊發

Agentic AI 加速全面滲透

Agentic AI 在汽車產業的落地應用，主要聚焦三大方向：自動駕駛安全提升、智慧座艙體驗升級，以及智慧製造與供應鏈優化，成為推動汽車產業邁向智慧化的關鍵技術。

在自動駕駛領域，Agentic AI 透過多個 Agent 即時協作，突破傳統模組化系統彼此獨立運作的限制。感知、規劃、控制與安全等 Agent 可同步運行並共享資訊，使系統能即時應對複雜且不可預測的路況。例如面對行人、自行車或臨時施工等情境，多個 Agent 可快速協同決策，規劃最安全的行駛路徑，並透過閉環學習持續優化決策能力。

在智慧座艙方面，Agentic AI 使車輛從被動回應轉向主動服務。語音、導航、娛樂與車況等 Agent 協同運作，可理解用戶意圖與情境，提供個人化體驗。例如當偵測到駕駛疲勞時，系統不僅會發出警告，還會主動播放提神音樂、調整車內燈光，並在導航中搜尋最近的休息站，形成完整解決方案

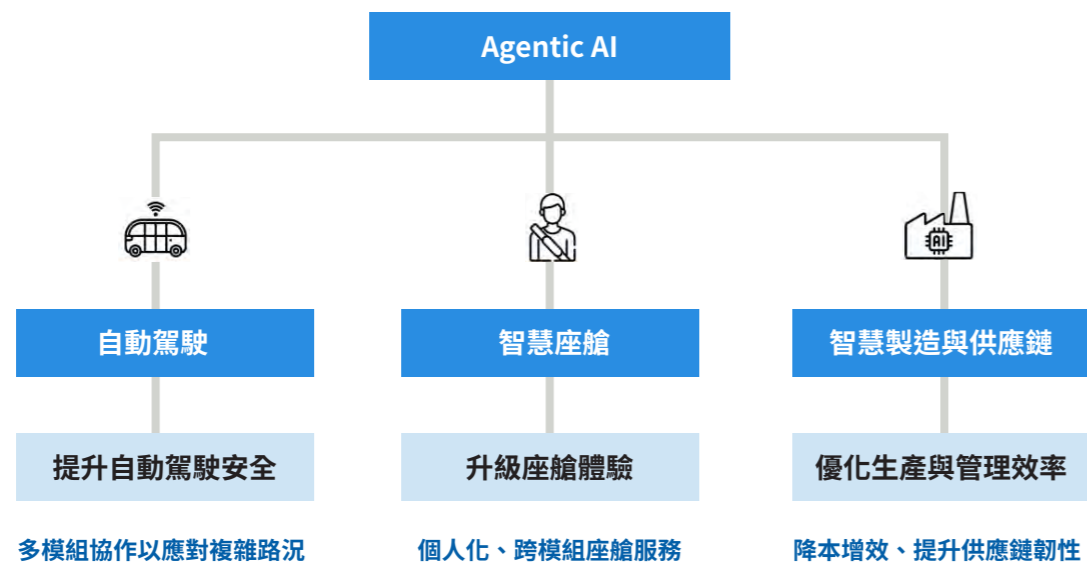
在智慧製造與供應鏈方面，Agentic AI 可實現生產流程與資源調度最佳化。排程、品質檢測與設備維護等 Agent 可依據即時數據自主決策，降低停機風險並提升產線效率。同時，整合 ERP 與供應鏈資訊，有助於優化庫存與物流調度，提升整體營運韌性。

Agentic AI、AI Agent、生成式 AI 功能特色對照表

項目	Agentic AI	AI Agent	生成式 AI
核心定義	多個 AI Agent 透過協作、共享記憶與決策，展現系統級智慧能力	利用 LLM 進行推理，並可調用工具與記憶模組完成特定工作	主要用於內容創建，依據輸入指令生成文字、語音或圖像等
自主能力	高 主動根據目標執行任務	中 能在有限範圍內自主行動	低 需依賴用戶輸入指令
記憶能力	高	中等	有限
範例	自動駕駛系統中，感知、規劃等 Agent 互相協作	車用 AI 助理處理駕駛者需求，如訂位、導航等	智慧座艙中，生成語音回覆或娛樂內容
限制	協作複雜度高，存在錯誤傳遞與控制風險	單一 Agent 難以處理全局任務	缺乏行動力，無法自主規劃或操作
發展階段	汽車產業仍在初期發展階段	正逐步導入汽車等產業	已大規模商用

資料來源：亞馬遜、NVIDIA，DIGITIMES 整理，2026/4

Agentic AI 在汽車產業可落地的三大應用場景



資料來源：DIGITIMES，2026/4

Agentic AI 時代來了
未來 5 年汽車產業競爭邏輯將全面改變

Agentic AI 在短期內(1-3年)，應用將集中於單一場景，如智慧座艙語音助理、自動駕駛導航模組與車輛品質檢測等，功能明確且導入門檻相對較低，有助於技術快速落地。

進入中期(3-5年)，多個 AI Agent 將逐步實現跨模組協作。智慧座艙、自動駕駛與智慧製造等系統中的不同 Agent，將透過資料共享與協同決策，形成更高效率的整合應用。長期而言(5年以上)，預估 Agentic AI 有望形成跨產業與跨車廠的智慧生態，加強不同場域

的多個 AI Agent 互相協作，推動產業進入高度自動化與智慧決策時代。

然而，Agentic AI 的推廣仍面臨多重挑戰。技術層面上，多 Agent 協作增加系統複雜度，單一 Agent 錯誤可能影響整體決策，因此穩定性與可靠性仍待強化。應用層面上，開發成本高且通訊標準尚未統一，限制業者導入速度。治理層面則涉及責任歸屬與資料隱私等議題，例如自駕事故責任認定與數據使用規範，均需法規與監管機制同步完善。



寬溫 SSD 解決方案

無懼極端環境 運作穩定如一

-40°C

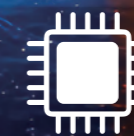
85°C



寬溫運作
-40°C ~ 85°C



高可靠性設計
適用嚴苛環境



嚴選原廠元件
長期供貨支援



高效能
穩定持續運作



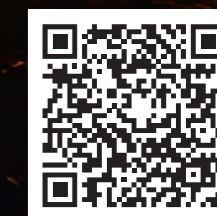
資料安全
端對端資料保護



6月2日-5日, 2026

台北南港展覽館
二館4樓

展位: **R0924a**



聯絡我們

建興儲存科技 (SSSTC) 為鎧俠 (KIOXIA Corporation) 子公司，專注於固態硬碟 (SSD) 的研發、製造與銷售，產品應用涵蓋企業級 / 資料中心、雲端運算、用戶端電腦及工業領域。

DIGITIMES 行動版 APP

淬鍊知識，掌握未來
全方位行動服務讓您資訊不漏接

報導 提供科技產業、區域市場、智慧應用不同領域的即時、專業、豐富的內容，兼具速度、深度與廣度的產業鏈脈動資訊。

影音 聚焦產業動態、科技趨勢與人文視角，精選優質節目，帶您掌握最前沿的科技洞察與深度剖析。

活動 匯聚產業領袖、專家學者與分析師，深入探討最新科技趨勢與市場動態，分享前瞻洞見，協助企業掌握市場先機。

月訂	季訂	年訂
600	1500	5200

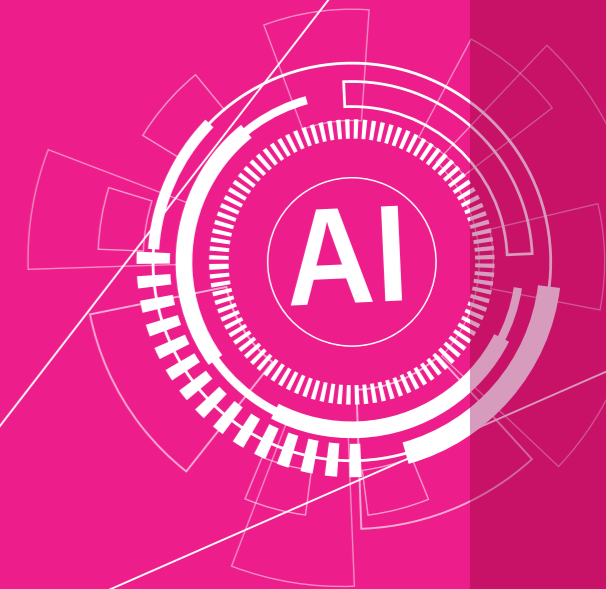


立即訂閱

KIOXIA

鎧俠 成就創新

為 AI、行動裝置、車用和資料中心
所打造的記憶體與 SSD 解決方案
南港展覽館二館 3樓 X0001



AI 電力瓶頸下的短期能源解方 AI 資料中心將加速配置儲能系統

人工智慧資料中心 (AIDC) 正進入 GW 級電力競賽時代，能源成為限制算力擴張的關鍵變數，而電池儲能系統 (Battery Energy Storage System ; BESS) 因具備快速部署與高功率輸出特性，為短期能提供資料中心 MW 級調度容量的成熟解方。AIDC 儲能市場已形成三類型供應商競逐，其中以儲能系統整合商在 AIDC 部署進展最快，預期 2026 年興建的 AIDC 將加速配置儲能系統。

AIDC 用電攀升 能源成算力擴張關鍵限制因子

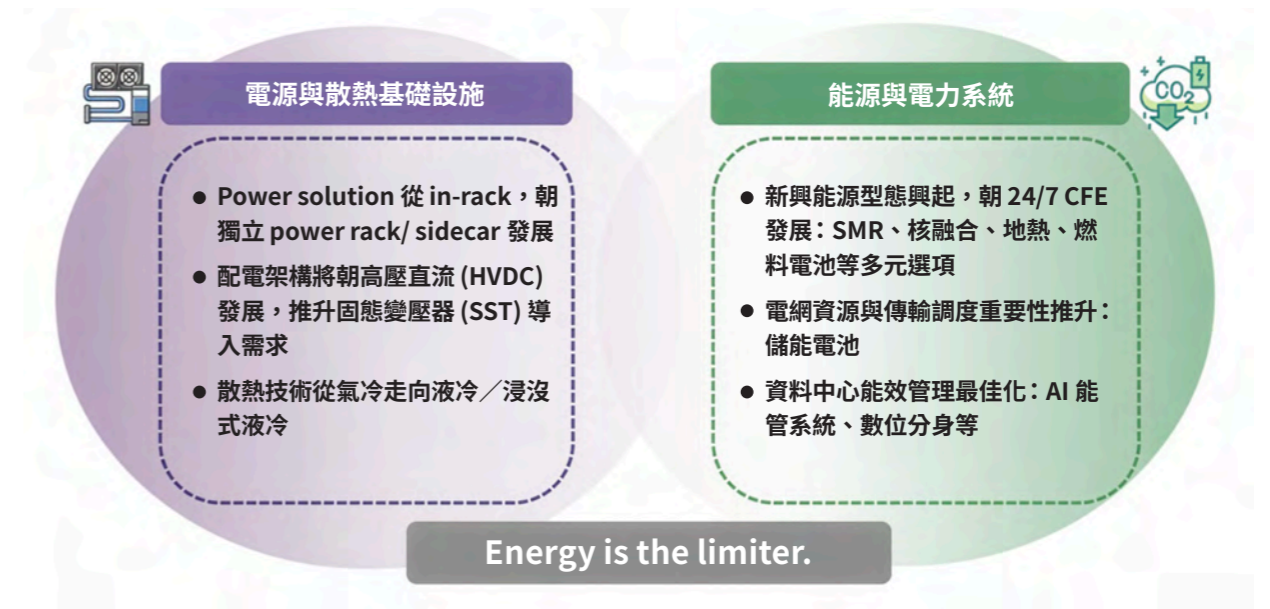
從 AIDC 用電需求的轉變歷程來看，過去 AI 晶片功率低於 1kW，現在若以 NVIDIA GB200、GB300 晶片為例，單顆 GPU 功耗已超過 1kW，若是 GB300 NVL72 機櫃總耗能更是達 120~140kW。DIGITIMES 預估，2030 年單顆 AI 晶片將超過 2kW，AI 伺服器機櫃將達 MW 級，AIDC 將進入 GW 級別，預期 2030 年全球資料中心用電量將突破 1,000TWh。

目前 Meta、OpenAI、xAI 皆已規劃 GW 級別 AIDC，Meta 預計最快於 2026 年投入使用。其中，OpenAI 和甲骨文等共同推動的星門計畫 (Stargate)，資料中心容量目標為 4 年內達 10GW，在規模上最具企圖心，然而近期 OpenAI 卻從自建資料中心，改為優先租用大型雲端供應商伺服器，反映的是，AI 基礎設施競爭已由算力，轉向建設速度與能源取得能力。另外值得關注的

是，xAI 宣稱已於 2026 年 1 月率先上線 GW 級 AI 訓練叢集，較 Meta 更快進入 GW 規模，關鍵在於 xAI 的能源策略，採取大量部署燃氣渦輪機和儲能系統。

當前 AIDC 討論的關鍵議題是，能源成為限制算力擴張的核心變數，AIDC 價值鏈面臨關鍵的雙軸變革，一是電源與散熱基礎建設，為 server 內部架構，包括 power solution 朝獨立 power rack/sidecar 發展、配電架構朝高壓直流發展、散熱技術走向液冷等議題，以提升單位算力能效；二是能源與電力系統，為 server 外部的能源架構，值得關注的是新興能源型態 24/7 無碳能源 (Carbon Free Energy ; CFE) 的興起，包括燃料電池、儲能電池、核能和地熱等，以及儲能電池轉變為電網資源配置與電力調度的核心關鍵節點等。

AI 資料中心價值鏈的雙軸變革



資料來源：DIGITIMES，2026/4

註：CFE 為無碳能源 (Carbon Free Energy)；SMR 為小型模組化反應爐 (Small Modular Reactor)。

BESS 為 AIDC 短期能源解方 AIDC 儲能競爭態勢已形成

全球 AIDC 發展將出現「算力建設速度超過電力建設速度」的結構性落差，而電池儲能系統 (Battery Energy Storage System ; BESS) 因具備快速部署與高功率輸出特性，短期即能提供 MW 級調度容量，為滿足資料中心高負載容量的關鍵能源配置。

值得關注的是，在 NVIDIA 推動的資料中心 800 VDC 架構中，儲能將不再只是備援系統，而是被定位為電力架構中的關鍵主動元件，可做為系統級電力調度的核心，包括位於中壓電網前側的 BESS，著重於電網併網與園區級穩定供電，以及位於 DC 配電後側的 BESS，則專注於調節 AI 負載的即時功率。

DIGITIMES 觀察，AIDC 儲能系統供應鏈競逐態勢已形成，三類企業分別從「電芯供應」、「系統整合」、「電力架構主導」等層面切入 AIDC 儲能市場，未來競爭焦點將由單一產品，轉向整體電力架構與電網參與能力。

電芯供應商類型的代表性業者有寧德時代、海辰儲

能，以中系業者為主，在 AIDC 電芯的開發上，皆朝高循環壽命、長時儲能、大容量發展，追求成本與能量密度優勢，該類型業者不僅供貨給 BESS 系統整合商，也同樣是其在 AIDC 儲能市場的競爭者。

BESS 系統整合商類型的代表業者有美商 Tesla 和 Fluence，以及中系業者陽光電源，多數業者皆掌握能源管理系統 (Energy Management System ; EMS) 功能，部分業者具備自研功率調節系統 (Power Conversion System ; PCS) 能力，此類型業者目前在 AIDC 儲能市場部署進展最快速。

電力基礎設施業者則包括 NVIDIA 在推動 800 VDC 資料中心電力系統所點名的主要產業夥伴，例如 Vertiv、施耐德電機 (Schneider Electric)、Eaton 等，這類型業者掌握資料中心整體電力架構，並將儲能電池納入該架構設計中，預期此類型業者在未來 AIDC 儲能系統中，將扮演更關鍵角色。

科技網

即時新聞

觀點分析

產業情報

洞悉產業趨勢，驅動決策前行

每週提供百則以上新聞、相關議題及延伸閱讀，具即時性、效率性、豐富性，及對未來趨勢論點的探討延伸。重視各領域供應鏈之市場、產業、技術、產品等資訊的完整度與深度，讓讀者能以最快的時間掌握產業動態與趨勢。

試用申請



AIDC 儲能市場三大類型主要供應商一覽

電芯供應商	BESS系統整合商	電力基礎設施業者
<ul style="list-style-type: none"> 提供高循環壽命、大容量、長時儲能、低成本電芯，主導成本與能量密度優勢。 	<ul style="list-style-type: none"> 將電芯、PCS、EMS等整合為MW/GWh級儲能系統。 	<ul style="list-style-type: none"> 掌握資料中心內部配電、UPS、變壓器與整體電力架構。
宁德时代 瑞豐儲能	TESLA FLUENCE 阳光电源 SUNGROW	VERTIV Schneider Electric EAT•N

資料來源：DIGITIMES，2026/4

預期 2026 年 AIDC 將加速配置儲能系統

北美區域為 AIDC 配置儲能設備需求最為顯著的市場，馬斯克旗下公司的 AIDC 已成為 BESS 的試驗場域，而 Fluence 目前洽談中的 AIDC 儲能系統訂單更是超過 30GWh，預期 2026 年 AI 算力建設將帶動一波儲能系統建置需求。

截至 2026 年 2 月初，Tesla 的 Cortex 2 超級運算叢集現場已部署約 150 台 Megapack 儲能系統，預計 2026 年中上線；xAI Colossus 資料中心亦陸續部署 156 台、168 台 Megapack，以每台 3.9MWh 容量計算，兩期總計約 1.2~1.3GWh 規模的儲能容量，為目前 AIDC 最大規模的儲能部署。目前 AIDC 部署的 Tesla Megapack 多為既有二代 3.9MWh 產品，最新 5MWh Megapack 3 預計將逐步在後續專案應用。

Fluence 在 2025 年第 4 季財報會議中提及 AIDC 潛在

儲能訂單超過 30GWh，顯示 AIDC 成為儲能市場的重要需求來源，且客戶需求多為 6 小時儲能，以獲得更快的併網進度、降低 AIDC 停機風險、平滑電力波動。目前 Fluence 已部署的儲能專案多採用 Gridstack Pro(含 Pro 5000) 儲能電池為主，預期洽談中的 AIDC 專案最可能採用的也是 Gridstack Pro 5000 儲能系統。

預估 2030 年全球 AIDC 儲能需求將達 200~300GWh，以美國市場為最大宗，DIGITIMES 認為，從區域格局來看，美國目前在 GW 級 AIDC 建設與電網瓶頸壓力下，已成為當前 AIDC 儲能需求最為顯著的市場。隨儲能電芯逐漸標準化，AIDC 儲能系統的競爭重心由電池轉向 PCS 與系統整合能力，而在未來資料中心逐步導入 800 VDC 架構下，預期系統核心將移轉至固態變壓器 (Solid State Transformer；SST)。



廣盛科技
創新資料管理解決方案領導品牌

以技術驅動企業基石 以韌性守護未來



親臨展位見證 AI 基礎架構的未來創新

N1301 南港展覽館 1 館 4 樓

2026 年 6 月 2 日至 6 月 5 日

9:30 - 17:30



立即預約專屬諮詢



區塊儲存



統合儲存



運算節點

TEAMGROUP *Team*
十銓科技

100% SECURE

YOUR DATA YOUR TECHNOLOGY

臺北南港展覽館2館

P1225



AI 覺醒 極速進化

臺北南港展覽館1館

I0407a

AI TOGETHER

2026年6月2日至5日

今日必看重點:

儲存及管理解決方案區

📍 南港展覽館二館四樓

AI 機器人區

📍 世貿一館

創新與新創展區

📍 南港展覽館二館四樓



行動導航
官方APP



完整資訊
官方網站



1F | Nangang Hall 1 | Booth I-1330

Out in Front™

Fusion moves with the market, providing decisive insights, anticipating needs, and taking immediate action.

 Sourcing

 Cost Savings

 Inventory Management

 Excess Mitigation

 Product Lifecycle Management



Find out what makes us different.

Visit our website at fusionww.com.



COMPUTEX
TAIPEI
6/2 ~ 6/5

歡迎蒞臨

映泰展位：P0914
台北南港展覽館二館一樓

BIOSTAR 映泰 COMPUTEX 2026

強勢佈局 Agentic AI，引領邊緣運算新紀元

BIOSTAR 映泰於 Computex 2026 展現邊緣 AI 策略與產品的全面進化！除了深耕智慧製造、零售與城市等領域，今年更將應用大舉拓展至 VLM、VLS 及當前最受矚目的 Agentic AI，並深化與 Edge AI 生態系夥伴的合作，加速產業數位轉型。

針對極耗算力的先進 AI 需求，映泰重磅推出搭載 NVIDIA Jetson Thor 模組的「MS-NAT5000/4000」；展會現場，MS-NAT5000 攜手國際大廠展出 VMS 及 VSS 解決方案。同時發表高階工作站「MW-W88U4-S」，並實機展示企業級代理式 AI 應用；亦推出搭載 Intel Core Ultra 5 AI 處理器的「MT-U335/U325」與「MT-PRO U332/U325」，全面躍升邊緣運算效能。

EdgeComp 系統更突破極限推出微型「MU-N150」，且 MS-X7433RE、MS-X6413E 與 MU-N150 皆全面支援嚴苛工業環境的導軌 (DIN-Rail) 安裝。現場也將透過「MT-N150」與 DeepX 合作展示邊緣 AI 應用，以及「MT-N97-

MX3」攜手 MemryX 展出場域安全 AI 應用。

此外，在邊緣運算主機板 (Edge Computing Motherboards) 方面映泰亦精銳盡出，完整展出包含 BIW88-AHS、BIPTL-IHT、BITWL-IHT、BIWCL-PAT、BITWL-N150 以及 ERX93-AXP 等多款強悍新品，提供客戶最彈性的硬體建置選擇。

映泰強調，EdgeComp 邊緣 AI 解決方案已全面開花落地，未來將持續深化應用，助力企業邁向智慧化轉型，讓 AI 技術真正融入日常營運，成為企業建置邊緣運算的專業夥伴。

BIOSTAR 映泰
邀請您共襄盛舉

南港展覽館二館 1 樓
展位：P0914

2026.6.2 (二) - 6.5 (五)

“ TSLG耐落
扣件防鬆價值
解決方案
提供者 ”

可靠安全高效能
功能性預塗膠應用科技
「價值解決方案提供者」

TSLG耐落®
Value Solution Provider



耐落集團產品已成為業界螺絲防鬆首選。

2026
台北國際電腦展

台北世界貿易中心展覽館一樓
1 樓攤位 A0309

可安排專業人員
提供扣件防鬆諮詢服務

電話 (03) 475-7777
網址 www.tslg.com.tw

TSLG 耐落集團是全球扣件功能膠預塗技術的領導廠商，本著「致力扣件預塗應用與創新，讓產品安全與生活安心」的使命及「專注用心、追根究柢」的精神，完整提供高效能的預塗式防鬆、防漏、防焊渣、防鎖死、導電及防電位腐蝕等服務，成為功能性預塗膠應用科技的「價值解決方案提供者」。

執行長鍾修城表示，耐落集團成立迄今逾 40 年，多年來除不斷加速提升塗佈科技與工程應用整合能力，並結合全球知名扣件功能預塗材料品牌，包括美國 NYLOK、德國 precote 及 LOCTITE 等已通過 NAS (國際航空規格)、MS (美國軍事規範)、IFI (美國工業扣件協會)、DIN (德國規範) 等產品認證，並能達到 IPX7 防水等級，通過相關國際環保與品質項目認證，為世界各大頂尖品牌如 Apple、Dell、HP、acer、AUSU、amazon 等指定應用，並廣泛使用在氣動工具機、線性滑軌、伺服馬達、減速器等自動化設備零件中。透過精密的塗佈科技預塗於扣件上，不但提高客戶組裝效益，確實達到扣件防鬆防漏及其他應用功能，也可大幅提升產品的品質、可靠度、安全與價值。



A Chip that Cools Chips

Introducing xMEMS μ Cooling™ — solving thermal bottlenecks for Physical AI.

xMEMS主動式微型散熱晶片

突破實體AI效能極限

用晶片幫晶片降溫，徹底解決散熱瓶頸



一起見證散熱革命

Visit xMEMS at

Booth J1 229a



Taipei, Taiwan | June 2-5, 2026

焦點廠商

智微科技股份有限公司

攤位號碼台北六福萬怡酒店 9樓 - 海廳



電話 886-3-5797389

官網 www.jmicron.com

JMB595- 高速傳輸多盤位儲存解決方案
釋放極致效能—打造多盤位儲存新架構

台灣鎧俠股份有限公司

攤位號碼 X0001



電話 886-2-5089909

官網 www.kioxia.com

COMPUTEX 2026 南港二館三樓 X0001 參展，鎧俠將展示其在 AI 時代最前端的快閃記憶體與 SSD 解決方案，並以 SSD 在 AI 中的關鍵角色為題於 6/4 14:30-14:55 假 701 室，探討 SSD 在 AI 中的關鍵角色，邀您與鎧俠共同洞見儲存技術的未來並成就創新。

宇瞻科技股份有限公司

攤位號碼 I0108



電話 886-2-22678000

官網 www.apacer.com

針對 Edge AI 應用，我們有解決散熱瓶頸、提高能耗表現、強化可靠度的工業儲存產品與技術；還有 AOI 光學檢測設備解決方案，以及膽固醇電子紙產品。消費性產品則有最新電競記憶體模組與 USB4 的 SSD 等。

慧榮科技股份有限公司

攤位號碼 G0001



電話 886-2-22196688

官網 www.siliconmotion.com

Edge SSD、嵌入式 eMMC/UFS 和可攜式 SSD 控制晶片、Ferrari 車用儲存解決方案，並聚焦 AI 基礎架構應用，包括企業級開機碟與 SSD 控制晶片，以及顯示介面解決方案，展現在 AI 時代的儲存創新。

技嘉科技股份有限公司

攤位號碼 K0802



電話 886-2-8912-6699

官網 www.gigacomputing.com

AI 算力正從虛擬走向現實，GIGABYTE 攜手 NVIDIA 技術生態，於 COMPUTEX 2026 完整展示次世代 AI 基礎架構解決方案。從極速部署的 AI 運算中心、支援 NVIDIA GPU 的液冷散熱設計，到整合 AI Ops 的智能維運平台，讓龐大算力化繁為簡，打造高效、節能、可視化的 AI Factory 新典範，歡迎蒞臨現場解鎖未來。

建興儲存科技股份有限公司

攤位號碼 R0924a



電話 886-2-87982886

官網 www.ssstc.com

建興儲存 (SSSTC) 展出完整工業級與企業級 SSD 產品線，憑藉卓越穩定與耐用特性，廣泛應用於工業領域、企業級/資料中心、雲端運算，及用戶端電腦等市場。此次展出聚焦為 AI 資料中心打造的「浸沒式冷卻儲存解決方案」，因應高算力帶來的散熱挑戰，優化電力使用效率，協助 AI 部署的同時，落實 ESG 永續目標。

安費諾

攤位號碼 J0632



官網 www.amphenol.com

全方位資料中心互連技術—聚焦 AI 算力革命，安費諾展出 XtremePass™ CPC 與 XPO 光學 OverPass™ 領先方案。結合康普戶外光纖接續盒，強化資料中心互連 (DCI) 韌性，並整合多款高速連接器與線纜，提供從機櫃內到跨園區的完整佈局，定義次世代 AI 基礎設施的極致效能。

意象無限股份有限公司

攤位號碼 Q0802



電話 886-2-89115121

官網 www.imagebroad.com

Multimodal HMI (多模態人機介面) 由 iBLab 以 iBTPS-1104 為核心打造，整合水流下穩定觸控、力感測、隔空手勢與觸覺回饋，讓系統能精準辨識使用者意圖，提升操作效率與可靠性。本次展出涵蓋戶外、工業、家電與航海應用，提供系統整合商 (SI) 快速建構差異化產品的關鍵平台。

十銓科技股份有限公司

攤位號碼 I0407a / P1225



電話 886-2-82265000 官網 www.teamgroupinc.com

全球記憶體領導品牌十銓科技於南港展覽館二館 P1225 以「100% Secure Your Data, Your Technology!」為題，核心聚焦軍工及企業級資安防護，全面賦能工業儲存應用需求。並同步於南港展覽館一館 I0407a 以「AI 覺醒·極速進化」為核心，展出針對生成式 AI、高效能運算、創作者與電競的頂尖儲存與記憶體解決方案。

泰科電子

攤位號碼 J0106



官網 www.te.com

TE 將展出次世代 AI 資料中心關鍵技術：800V HVDC 機架級電源方案、高達 750kW 的液冷散熱技術，以及符合 ORv3 標準的 48V 電源架構。助力 AI 基礎設施實現高效、永續與規模化部署。

台灣耐落股份有限公司

攤位號碼 A0309



電話 886-3-4757777 官網 www.tslg.com.tw

TSLG 耐落集團致力於提供扣件功能膠預塗技術，本著「致力扣件預塗應用與創新，讓產品安全與生活安心」的使命及「專注用心、追根究底」的精神，提供預塗式防鬆、防漏、防焊渣、防鎖死、介電絕緣等服務，成為功能性預塗膠應用科技之「價值解決方案提供者」(Value Solution Provider)。

趨勢科技

攤位號碼 L0417a



官網 https://go.trendmicro.com/tw/business/COMPUTEX2026_event/index.html

趨勢科技以「Adopt AI Fearlessly」為主軸，於 COMPUTEX 2026 亮相。集結四大 AI 力量，橫跨企業 AI 治理、家庭防護、Physical AI 到主權基礎建設。TrendAI™，趨勢科技企業事業群、全球 AI 資安領導品牌，聯手 NVIDIA、Anthropic 等頂尖 AI 生態系夥伴，為企業提供全面的 AI 可視性與整合式資安防護。……

廣盛科技股份有限公司

攤位號碼 N1301



電話 886-2-77202118 官網 www.qsan.com

QSAN 致力於提供高效穩定的 IT 基礎架構解決方案，今年 COMPUTEX 2026 將揭曉專為 AI 工作負載設計的新一代架構，助力企業簡化資料管理並強化營運韌性，驅動 AI 應用落地。憑藉超過 20 年的深厚研發經驗，為全球企業提供可靠的技術支援。

台灣英飛凌科技股份有限公司



官網 www.infineon.com

英飛凌總裁 Adam White 將於 COMPUTEX 論壇發表主題演講「驅動 AI 時代的能源關鍵，從電網到核心再到實體 AI」(6 月 4 日)，歡迎一同洞悉 AI 時代能源版圖的新趨勢。

明緯企業股份有限公司

攤位號碼 K0725a



電話 886-2-2299-6100 官網 www.meanwell.com.tw

本次展出超薄型導軌電源 XDR 系列、高功率雙向電源 BIC-5K，以及高效小型機殼 NSP 系列等新產品。並演示系統電源、工業自動化、智能燈控、能源管理等解決方案，全面對應儲能系統、智慧製造與綠能應用需求。

台灣卡爾蔡司股份有限公司

攤位號碼 J1109



電話 886-2-2182-2985 官網 www.zeiss.com.tw

蔡司集團整合工業量測、顯微鏡與半導體跨事業體能力，打造晶片到機櫃 (Chip-to-Rack) 端到端品質解決方案，涵蓋晶片、PCB、散熱、連接與機櫃整合等關鍵環節。透過 X-ray、電子顯微鏡、結構光與 CMM 等技術，支援從失效分析到自動化檢測應用，全面提升 AI 硬體良率、可靠性與全價值鏈品質管理。

美商知微電子

攤位號碼 J1 229A



官網 xmems.com

µCooling™ 晶片級主動散熱技術，用晶片幫晶片散熱，以 MEMS 微機電結構進行晶片級冷卻，突破 Physical AI 以及 Edge AI 的熱瓶頸。

亞奇雷科技股份有限公司

攤位號碼 L1117a



電話 886-27937256 官網 agi-gear.com

亞奇雷正式進軍工控市場，推出工業級應用方案與 DDR5 RDIMM 記憶體，開啟 AI 運算新紀元。攜手 StorArt 聯合開發，更結合熱門動漫《膽大黨》打造創新合作話題。此外，也推出獨家熱感變色散熱專利技術，兼具高效散熱效能與科技美學設計。

孚昇電子

攤位號碼 I-1330



官網 www.fusionww.com

全球電子元件分銷商。專注於半導體、儲存、記憶體及供應鏈風險管理。

一座地震島，如何成為全球科技的心臟？

並百年 不年 孤寂



科技產業分析資歷近 40 年
DIGITIMES 創辦人黃欽勇揭密

半導體和 AI 如何改寫世界
台灣為何成為關鍵？

作者到府產業導讀
馬上預約 >>>



COMPUTEX 2026



Bringing AI into the Real World: The Future of Physical Intelligence

NXP CEO Keynote

Rafael Sotomayor

President and CEO
NXP Semiconductors



Wednesday, June 3rd, 2026
10:30 (UTC + 8)
TaiNEX 2, 7F

GIGABYTE

 NVIDIA

From Your Desk to the AI Factory

從桌面，到 AI 工廠



GIGABYTE W775-V10-L01

Powered by NVIDIA GB300 Grace™
Blackwell Ultra Desktop Superchip

桌上型電腦超級晶片



NVIDIA Vera Rubin NVL72

GIGABYTE Solutions for the NVIDIA
Vera Rubin Platform

技嘉 NVIDIA Vera Rubin 平台解決方案

 **COMPUTEX**
TAIPEI

南港展覽館 1 館 1F

K0802 展位